

江苏长电科技股份有限公司

2026 年半年度业绩说明会记录

近日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过进门财经电话会议、上证路演中心转播及网络文字互动方式召开了 2026 年半年度业绩说明会，公司董事/首席执行官（CEO）郑力先生、独立董事董斌先生、董事/首席财务长梁征先生、董事会秘书袁燕女士、副总裁吴宏鲲先生等相关人员就公司 2026 年上半年经营成果及财务具体情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1. 国内 AI 芯片等客户对于需求持续快速增长的能见度不断提高，是否可以更新先进封装的潜在收入空间？

短期来看，国内市场对 AI 的投入已显著超出原有预期，先进封装需求随之超预期增长。公司正积极推进江阴高端先进封装工厂的扩产。今年 6 月宣布建设的第二座高端先进封装工厂目前正加快推进建设。海外市场方面，海外晶圆大厂项目溢出趋势日益明显，叠加海外定制化高端存储需求，为先进封装打开新的增长空间。中长期来看该领域发展空间巨大。

2. 汽车电子是否有看到下游客户有需要去化库存的压力？还是客户的需求依然保持快速增长？边际变化的情况如何？

从整车厂需求端尚未看到明显的数量增长，但从封测环节并未感受到芯片企业或封测端存在去库存压力。主要原因在于，新兴车厂电子电气架构持续向集中化、平台化演进，单车半导体价值量及芯片用量均有较为明显提升。上海临港汽车工厂当前正加速设备导入，新增产能迅速达到满产状态，需求景气度清晰可见。鉴于客户技术平台持续升级、需求超出原有预期，公司已在临港工厂追加布局车规级晶圆级封装产能，并加速推进，预计将于明年实现投产，以满足智能汽车对先进封装的强劲需求。

3. 先进封装长电微工厂预期达到盈亏平衡的时点，同时和新设立的高端先进封测工厂的定位差异？

公司高端先进封装业务由多个工厂协同完成，长电微承担其中部分工序，其余环节由其他工厂配合生产，当前长电微仍处于产能爬坡阶段；从今年上半年的经营情况来看，今年上半年其亏损收窄已较为明显。随着明年市场对高端先进封装需求继续增长，公司产能持续释放，长电微盈利改善趋势明确；与新设立的临港高端先进封装工厂相比，两者定位存在差异，长电微启动较早，配套工厂内部协作已顺利展开；临港工厂尚在建设中，产品定位与技术路线亦有所不同。临港工厂一方面承接长电微产能扩大的需求，另一方面面向 2028 年及以后市场所需的新工艺技术与产能，将同步布局更高集成度、更高带宽、更大尺寸的先进封装需求，形成差异化布局。

4. 全球 AI 先进封装需求旺盛，公司在产能端是否已经做好充足准备？如何看待自身在国内及全球 AI 先进封装领域的行业地位？

公司今年正积极扩充产能，明年将有更大规模产能释放。面向 AI 的封装需求旺盛，国内及海外工厂均需进一步扩充先进封装产能。从行业特征看，AI 需求具有显著的持续性与结构性特点，下半年需求将大于上半年，明年对产能的需求较今年更为显著，未来几年先进封装产能预计处于紧平衡状态。面对这一形势，公司正加快推进涵盖存储、算力、电力相关平台的技术导入，随着相关技术逐步量产落地，将更快、更好地满足客户对整体平台产品的需求。

5. 韩国工厂在 AI 及数据中心领域已取得明显进展，请公司领导展望一下韩国工厂后续发展。

韩国工厂面向 AI 的转型升级是公司近两年的重大战略，目前已取得积极进展。面向 AI 基础设施应用，公司一方面有序调整产能与资本开支导向，另一方面推进韩国两家工厂资源整合，通过腾笼换鸟释放产能空间，向高附加值产品集中。经过一年多努力，部分国际大厂乃至此前并非韩国工厂主要客户的 AI 头部企业，因先进封装产能溢出及整体需求扩张，亦导入韩国工厂高端先进封装业务，相关成果将在今年下半年至明后年明显释放。这将推动韩国工厂下游市场从通信

领域向 AI 算力、电力、存力延伸，有效对冲消费类手机增长乏力的影响，与公司战略布局高度匹配。

6. 是否可以介绍一下公司目前玻璃基板 TGV、PLP 面板级封装的进展和目标？

去年下半年，玻璃基板和面板级相关技术尚被定位为前沿性开发，而当前实际工艺需求已十分明显，公司正加快布局。相关业务已从前期研发阶段推进至中试线建设，公司已与多个项目及客户处于联合开发阶段。相关技术在技术层面仍面临一定挑战，但已成为行业生产端的重要趋势。

7. 公司光电合封（CPO）目前客户验证及交付情形？预期订单何时可以放量？2027 - 2028 年是否有机会形成实质收入，还是仍以战略性技术储备为主？

CPO 相关工作目前稳步推进，前期已完成点亮。客户正积极在其项目上与终端系统客户开展系统验证，国际市场与国内市场的系统端需求节奏均有所前置。公司正在加快布局，在可靠性验证、光电测试等方面已与客户建立联合测试能力。

8. 2026 年资本支出预算增长到 100 亿，主要投资方向能否拆分？2027 年资本支出预期是否继续增长？投资方向会不会有所改变？

从业务分类看，公司内部目前按五大板块进行组合管理：高端先进封装、先进封装、系统级/模组封装、主流封装以及测试。资本开支投向延续既有方向：一是产能扩充，重点投向先进封装领域，同时根据客户订单需求进行主流封装产能扩张；二是持续加大研发投入，应用领域主要集中在运算与汽车电子。按上述五类统计，上半年公司在主流封装方面的投入不到一成，剩余大部分投向先进封装、模组及测试等领域，其中高端先进封装占比超过一半。预计明后年资本开支将继续呈现提升趋势，以临港新工厂为例，高端先进封装投资规模呈数倍级扩大，已接近晶圆厂投资规模。公司亦将配合传统封装先进化趋势及测试能力建设，在上述方面持续强化投资。

9. 年初 100 亿资本开支和相关投入对应的产能投放进度，相应的收入增量贡献预期何时开始体现？结合国内和全球同业情况，是否会有设备采购瓶颈？

从资本开支执行进度看，公司今年上半年资本开支 47 亿元，同比增长接近 80%，通常下半年资本开支高于上半年。后续公司将结合市场需求、客户项目进展及产能建设情况，持续动态评估资本开支安排，并根据相关规则履行相应的审议和信息披露程序。上述投资转化为收入大体分为两类：一类为临港汽车电子工厂，场地已就绪，设备到位、产线建成后即可满产；另一类为高端先进封装领域，部分工艺与技术导入期及客户验证周期较长，收入转化尚需一定时间，相关工厂业绩体现仍有等待期，但后续增长趋势及客户需求的不确定性依然存在。设备方面，在行业高热度下部分核心设备交期有所拉长。公司过去几年持续加强供应链属地化与多元化建设，并从战略层面做好前置管理，针对长交期设备列出清单、提前下单，有效保障项目推进节奏、缓解交期压力。

10. 目前行业整体稼动率处于饱满状态，如何判断本轮景气的持续性以及如何展望下一季度景气度？如何看待本轮涨价的可持续性？

本轮景气周期有别于传统周期波动，主要驱动力来自 AI 基础设施及相关 AI 新应用、新产品带来的长周期结构性变化，公司对景气度保持乐观。当前后道特别是高端封测将逐渐成为行业放量的瓶颈环节。封测环节的价值贡献与价值创造正得到更好体现，其已成为决定芯片性能与交付的关键环节；在此共识逐步形成的背景下，公司的价格联动机制得到越来越多客户的理解与认同。公司将继续秉持价值导向、动态优化的定价原则，确保产品交付时效与质量，同时推动产能向高附加值方向调整。去年以来的涨价，一方面源于原材料价格逐步走高，另一方面也与公司持续加大资本开支、特别是高端先进封装投入带来的折旧增加有关，在成本端有所体现，国内同行及海外友商亦存在类似情况。星科金朋海外工厂将于下半年启动新一轮价格调整，具体将根据产品类型并结合海外大客户情况逐家协商确定。

11. 想了解下公司传统封装业务产能利用率情况以及下半年的指引？以及第二季度毛利率持续大幅改善的原因和下半年的指引。

传统封装业务产能利用率目前接近满载状态，预计下半年仍将维持这一水平。公司毛利率改善主要来自三方面驱动：一是产能利用率处于高位，规模效应得以体现；二是公司持续加强运营基本功、强化成本管控，通过智能制造及精益生产不断降低成本；三是封测环节价值日益得到客户与行业认同，封测环节的价值贡献与价值创造正得到更好体现。展望下半年，毛利率有望在上半年的较好表现基础上继续提升：一方面国内工厂持续满产，另一方面海外星科金朋工厂下半年将进入相对旺季，并持续加速向数据中心等高附加值业务转型，产品结构进一步优化，整体盈利水平与毛利率有望持续改善。

12. 公司最近几个季度运营效率提升显著，请问下半年及明年研发以及销售管理费用的指引如何？

销管费用方面，二季度环比一季度已有所下降。展望全年，临港工厂与长电微工厂产能爬坡态势良好，公司将持续加强销管费用管控；随着下半年营收规模增长，预计销管费用率下半年有望低于上半年。研发方面，公司持续加强投入，近年来研发费用率保持在 5% 以上，并呈逐步攀升趋势，研发费用率逐步提升具备确定性，且后期转化效果较好。公司研发重点聚焦玻璃基板面板级封装、光电合封（CPO）、多芯片异质异构集成等前沿高价值领域；随着先进封装战略深化，研发将持续加码，成果转化亦具备更高可预见性。

13. 公司在 CPO 光电共封装封测技术是否已实现量产并产生实际业绩收入？长电科技当前 CPO 封测业务的在手订单情况如何？预计 2026 年全年 CPO 业务能贡献多少营收？公司作为目前全球前 3 的封测企业，长电科技是否具备矽品精密同类的 CPO 光电共封装封测技术？

尊敬的投资者，您好！公司在 CPO（光电共封装）领域已完成与全球头部封测企业同等级别的技术布局，已与多家头部客户开展多年深度联合研发；近半年来公司在提升可靠性、优化成本结构方面取得显著突破，同时重点推进 CPO 光电测试能力建设。当前客户产品仍处于算力中心系统验证阶段，尚未实现大规模量产及实际业绩贡献，未来营收贡献需视客户验证进度及上量节奏而定，公司将持续把握 AI 算力基础设施带来的长期增长机遇。感谢您的关注与支持。

14. 公司在之前年报披露已经布局 CPO 封装方面。请问公司当前在 CPO 封装方案中，针对光芯片封装的散热问题有没有相关的布局。

尊敬的投资者，您好。散热是光电合封架构的核心技术难点之一，直接决定 CPO 产品的长期可靠性，公司对此已前瞻布局，正从材料及设计等维度系统推进。材料端重点优化基础材料热性能参数，解决芯片间及与基板间的热电匹配问题；设计端建立热-电参数双向反馈机制，基于先进封装技术平台提供差异化的堆叠结构，通过封装结构优化与热源管理实现精准温控、灵活适配，降低系统热阻。感谢您的关注与支持。

15. 下半年合同金额是多少，先进封装的价格有上涨吗？定价机制是什么？

尊敬的投资者，您好。去年以来，原材料价格持续走高，公司建立了价格联动机制，客户接受度不断提升。与此同时，公司顺应产业发展趋势和客户需求，加大资本开支力度，先进封装在产业链中的价值持续提升。公司秉持价值导向、动态优化的定价原则，推动新产能向更高附加值方向释放。

16. 临港先进封测项目建设进度，何时释放产能？

尊敬的投资者，您好。公司于 2026 年 6 月宣布在临港地区布局第二座高端先进封测工厂，正抓紧推动土建工作的开展，尽快完成产能建设，满足对未来产能的储备需求。

17. AI 先进封装下半年订单与毛利率展望？

尊敬的投资者，您好。当前国内工厂持续满载同时加快验证新增产能满足客户需求，海外星科金朋工厂产能利用率下半年将进一步提升，产品结构进一步向数据中心优化。展望下半年，公司毛利率有望同比提升。

18. 半年报显示，AI 服务器市场已迈入“中长期高景气成长通道”，预计景气何时传导到封测端？公司围绕 AI 服务器有哪些部署？

尊敬的投资者，您好。公司围绕面向 AI 数据中心的算力、电力、存力、互联加大产能建设和研发投入，上半年公司运算电子占比首次突破 30%、运算电子

领域营收同比增长 40%。

19. 请问上半年收入高端先进封装贡献率大概怎么样？高端先进封装预计什么时候可以得到客户验证并投产？

尊敬的投资者，您好。公司高端先进封装已经投产。

20. 我们下游产品类型比较多，AI 算力芯片、存储、端侧 AI 芯片、模拟芯片、功率半导体等等。想问一下公司收入如何拆解占比和增长？

尊敬的投资者，您好。公司 2026 年上半年营业收入按市场应用领域划分情况：通讯电子占比 27.4%、消费电子占比 23.2%、运算电子占比 30.1%、汽车电子占比 11.1%、工业及医疗电子占比 8.2%。其中，运算电子领域营收同比增长 40.4%，汽车电子领域营收同比增长 25.0%，业务结构持续向高附加值和高成长性方向优化。

风险提示：本次会议内容中涉及对行业前景的预测、公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应保持足够的风险意识，充分理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。